

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年7月28日 (28.07.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/069205 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G06K 19/00, H01L 21/50, 21/60
 (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/000095
 (22) 国際出願日: 2005年1月7日 (07.01.2005)
 (25) 国際出願の言語: 日本語
 (26) 国際公開の言語: 日本語
 (30) 優先権データ:
 特願2004-008313 2004年1月15日 (15.01.2004) JP
 (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.)
 [JP/JP]; 〒1630449 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 Tokyo (JP).
 (72) 発明者: および
 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 田中 耕輔

(TANAKA, Kousuke). 石坂 裕宣 (ISHIZAKA, Hironori). 田崎 耕司 (TASAKI, Kouji). 渋谷 正仁 (SHIBUTANI, Masahito). 新沢 正久 (SHINZAWA, Masahisa). 殿塚 秀彦 (TONOTSUKA, Hidehiko). 岩田 克也 (IWATA, Katsuya).

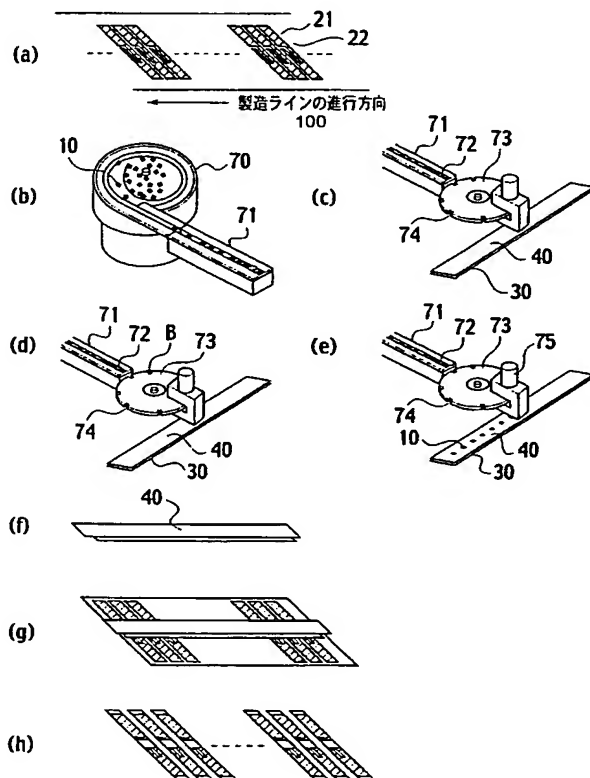
(74) 代理人: 三好 秀和 (MIYOSHI, Hidekazu); 〒1050001 東京都港区虎ノ門1丁目2番8号 虎ノ門琴平タワー Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,

[続葉有]

(54) Title: METHOD OF FOR MANUFACTURING ELECTRONIC DEVICE

(54) 発明の名称: 電子装置の製造方法



(57) Abstract: A method of manufacturing an electronic device comprising IC elements (10), on a set of opposite faces of which a first electrode (12) and a second electrode (13) are formed, a first circuit layer (20) where an antenna circuit (21) having a slit (1) is formed, and a second circuit layer (30) for electrically connecting the IC elements (10) and the antenna circuit (21). The IC elements (10) are placed individually in cutouts (74), into each of which one IC element (10) can be inserted, the cutouts being formed in the outer circumference of a disk-like carrier (70). Thus, with the method, an electronic device that is inexpensive and is produced with high productivity, and has improved communication characteristics is produced.

(57) 要約: 第1の電極12及び第2の電極13が向かい合った1組の各々の面に形成されたIC素子10と、スリット1を有するアンテナ回路21が形成された第一の回路層20と、前記IC素子10と前記アンテナ回路21とを電気的に接続する第二の回路層30とを含む電子装置の製造方法において、前記IC素子10を1個挿入可能な切欠き74を外周に複数有する円盤状搬送器70の前記切欠き74に前記IC素子10を個々に収め、前記円盤状搬送器70の回転により前記IC素子10Bを搬送することにより、安価で生産性に優れかつ良好な通信特性を得ることができる電子装置の製造方法を提供する。